

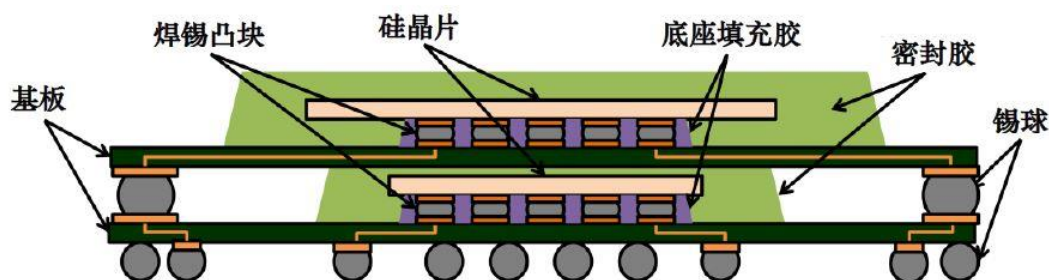
半导体封装材料阿尔法射线委托分析服务

2017年6月13日

三菱综合材料

三菱综合材料运用多年以来积累的关于阿尔法射线的评估及技术，将推出焊材以及各种半导体封装周边材料的阿尔法射线分析及评估服务。

对象产品:锡球/凸块、基板、底座填充胶、绿漆、以及其他（欢迎洽谈）



POP 封装结构图 (倒装芯片型)

近年来，由于 2.5D 及 3D 封装等封装技术的进步，不只是晶片下的凸块，同时也要求封装材料如绿漆、底部填充胶等，提高对阿尔法射线的管控。

为了协助客户严格把关阿尔法射线管理，借由开发低阿尔法射线焊材“MUL α S 系列”产品时所积累的丰富知识及经验，本公司推出了阿尔法射线委托分析服务。

分析概要

- 分析设备：流气式正比计数器
- 分析方法：依据 JEDEC STANDARD JESD221
- 分析样品：各种晶圆、金属板、电镀薄膜、焊锡膏、各种粉末（有挥发性粉末除外）、树脂薄板等。
- 交期：约 2 周（个别情况可商讨）
- 价格：另外提出报价

如有其他疑问，请咨询销售负责人

所需样品

<晶圆、电镀板、薄板等>

- 样品厚度：~5mm
- 面积：1,000cm²（铺在 28×36cm 的托盘）
⇒1,000cm² 以下的面积也可测量，但请先与我司商谈。
- 重量：~1,500g

提供样品时请附 SDS。

<各种粉末>

- 重量：500~1,000g
⇒请准备可涂在 28×36cm 的托盘上（面积：1,000cm²），厚约 1~2mm 的样品份量。

联系三菱综合材料

China	MMC SHANGHAI CO., LTD. Room 12B01, Winners Building 678, Gubei Road, SHANGHAI, 200336, China Phone +86-(0)21-6289-0022 Fax +86-(0)21-6279-1180
Taiwan	EUCARLA INDUSTRIAL CO., LTD. 19F-3, No. 56 Min-Sheng 1st Rd., Kaohsiung, 800 Taiwan Phone +886-7-2270999 Fax +886-7-2270998
	MMC ELECTRONIC MATERIALS TAIWAN CO., LTD. TAIPEI OFFICE 8F-1, No. 35 Kan-Ku Street, Taipei 103, TAIWAN R. O. C. Phone +886(2)2558-2895 Fax +886(2)2556-0035

您也可通过以下网站联系本公司

【三菱综合材料 电子材料事业 功能材料事业部】

<http://www.mmc.co.jp/adv/ele/zh/index.html>